

## 質問書に対する回答

(調査等名) 道央自動車道 輪厚スマートIC(改築)道路詳細設計

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	金抜き設計書について 舗装設計 連絡等施設設計に数量表作成は計上されないのでしょうか。	数量表作成は計上しておりません。	
2	参考見積について 交付されています参考図によると、連絡等施設設計の概略設計はSA、詳細設計はPAとなっていますが、その通りの人工を使用すると考えてよろしいのでしょうか。	本設計は、概略設計、詳細設計ともにスマートICの設計となります。 また、参考図「平面図(輪厚スマートIC上り)」に記載されている「輪厚SA上り線」表記はPAとなります。	
3	参考見積について 設計協議用図面作成A及びBは詳細図作成の簡易舗装工詳細図作成に準じて人工を使用すると考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載のとおりとなります。	
4	技術提案書の参考見積について 参考見積内訳書 様式 2-4(2)はワードではなくエクセルでの作成でもよろしいでしょうか。	参考見積内訳書 様式 2-4(2)に必要な内容、体裁が整っているのであれば形式は問いません。	

以 上